

脉冲加热器

脉冲加热器通过快速加热和冷却技术,在室温至 400°C 之间实现快速且可重复的温度控制。它在需要键合半导体元件或基板的半导体封装工艺中发挥关键作用。由于其快速热循环、高能效以及对周围区域的热变形最小化,该加热器可提升整体工艺质量和良率。

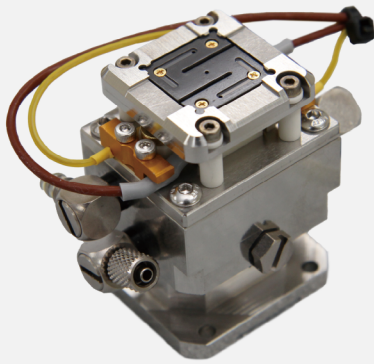
应用领域

Advanced Packaging

Thermo-Compression Bonding (TCB)

Flip-Chip

High Bandwidth Memory (HBM)



Pulse Heater

制造规格

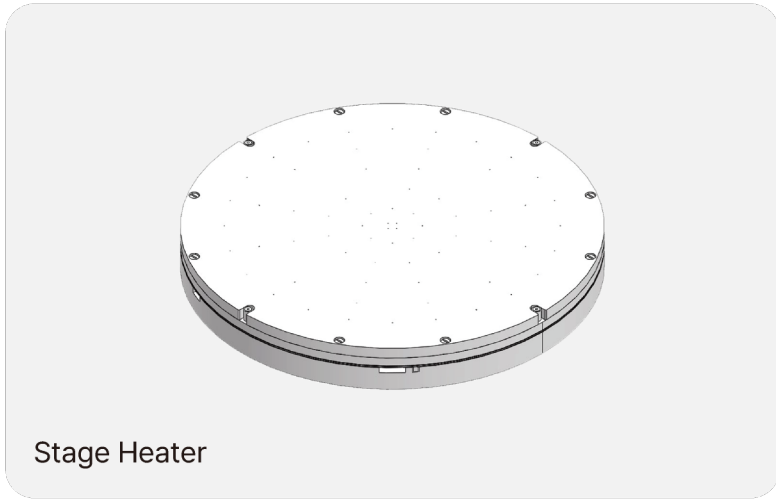
检验项目		规格
尺寸	尺寸	□16mm
	平行度	~ 5μm
	平面度	~ 2μm
功耗	无附属物	160W
	有附属物	270W
温度均匀性		最大值 400.8°C 最小值 399.1°C
工作温度		400°C
升温速率	100°C → 400°C	1.7sec
冷却速率 (空气压力 0.5MPa)	400°C → 100°C (AlN 附属物)	1.7sec (无附属物) 4.8sec (有附属物)
超调量		最大值 2°C
电阻		71Ω

阶段加热器

此加热模块用于半导体封装设备中的键合工艺，具备真空吸附功能以固定晶圆，并通过加热功能实现预热。

应用领域	Advanced Packaging	Thermo-Compression Bonding (TCB)	Flip-Chip	High Bandwidth Memory (HBM)
------	--------------------	----------------------------------	-----------	-----------------------------

制造规格



工作温度
<150°C

温度均匀性
 $\leq \pm 1\%$

材料
AlN

平面度
<2 μm

先进封装 | BOBOO HITECH的未来

随着 AI、5G、物联网等新技术的快速发展，对高性能半导体器件的需求正迅速攀升。

先进封装是一种突破传统封装工艺的创新技术，可提升半导体芯片的性能、功耗效率及小型化能力。

随着市场对更小、更强大、更高效的半导体芯片需求日益增长，先进封装在突破摩尔定律和传统晶体管扩展极限方面发挥着关键作用。